東海大學研發成果專利申請表

（專利申請表1）

申請日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 專利申請 名稱 | 中文 |  | | | | |
| 英文 |  | | | | |
| 1. 發明人代表 | 姓名 |  | | 聯絡電話 |  | |
| 單位/職稱 |  | | E-mail |  | |
| 1. 聯絡人 | 姓名 |  | | 聯絡電話 |  | |
| 單位/職稱 |  | | E-mail |  | |
| 1. 智慧財產權 歸屬 | □本校  □共有（請填寫下列共有單位名稱及成果歸屬比例）  本校【 %】、共有單位 【 %】  註：請檢附共有合約書  □其他（請說明）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| 1. 本研發成果來源   （計畫主持人須為發明人代表） | □國科會　□農委會　□經濟部　□其他補助機關：  □一般產學合作計畫　□本校教師職務成果（勾選本項者，免填下列欄位） | | | | | |
| 計畫編號： 校內編號：  計畫名稱： | | | | | |
| 1. 申請國家及 類型 | □中華民國　□美國　□日本  □其他國家：  理由： | | | | | |
| □發明專利　 □新型專利 □設計專利 | | | | | |
| 1. 公開揭露 紀錄 | 是否已公開？  □是　　　　□否，但未來會公開 □否，未來亦無公開之計畫（勾選本項者，下列公開資料免填） | | | | | |
| 已（或預計）公開之方式及日期：  □學位論文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_　　　　　\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （口試日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；繳交日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日）  □國內外期刊：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （投稿日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；(預計)出版日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日）  □技術公開演說：發表日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  （活動型式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_，例如：新聞、海報、口頭、書面等）  □計畫結案報告日：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  註：揭露本項資訊者，請檢附已發表之期刊、論文……等（如為外文，須附中譯本）。 | | | | | |
| 1. 檢附資料 | □專利申請表（表1）  □專利申請說明書（表2）  □專利申請費用分攤暨權益收入分配協議書（表3）  □計畫經費核定清單或計畫合約書影本。  □本申請案之電子檔請E-mail至產學與育成中心[iic@thu.edu.tw](file:///D:\1.★智慧財產權\1.★專利\1.★本校資料(含申請表格、委員會、申請案件資料)\1.法規及申請表格\2.專利相關表單\1.申請\iic@thu.edu.tw)。  □其他（如已發表論文等）： | | | | | |
| 發明人代表聲明：   1. 申請本案之內容（本申請表表1至表3所填報）完全係本人任職於東海大學期間之研究成果，確係發明人所發明，如有不實或損害他人權益情事，願自行承擔相關法律責任。 2. 發明人同意將所發明之專利申請權讓由「東海大學」申請專利。 3. 因可歸責於發明人或其研究計畫相關人員之事由，致本申請表第7欄之公開揭露紀錄有陳報不實之情形，而導致新穎性喪失，無法取得專利權者，發明人須自行負擔全部專利申請費用。 4. 發明人代表保證上述填報屬實，並同意上述聲明。 | | | | | | |
| 申請單位 | | | | | | 研發處 |
| 發明人代表簽章 | 單位主管 | | 一級主管 | | | 一級主管 |

東海大學研發成果專利申請說明書

（專利申請表2）

一、發明人資料**（必填）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本案發明人共 位 | | | | |
| 1 | 姓名 |  | 貢獻比例 | % |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |
| 2 | 姓名 |  | 貢獻比例 | % |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |
| 3 | 姓名 |  | 貢獻比例 | % |
| 身分證字號 |  | 國籍 |  |
| 服務單位 |  | 職稱 |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
| E-mail |  | | |
| 戶籍地址 |  | | |

註：

1. 發明人如超過3人，不敷使用時請自行增加欄位。
2. 所有發明人之貢獻比例合計為100%

二、專利資料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 有關此發明 最早的紀錄 | 日期 | |  |
| 公開資訊 | |  |
| （二） 相關先前技術 調查情形 | 1. 已檢索之專利資料庫（Database） 2. 已檢索之關鍵字（Keyword）   中文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  英文：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. 相類似技術或已經發表之文獻 | | |
| （三）  研發領域  （請先選大類，再選細項，**可複選**）  **（必填）** | □資通 電控 | □資訊工程　□電信工程　□電腦通訊　□微電子工程　　□網路科技　□光電工程　□電力工程　□自動化控制 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □工程 科技 | □機械工程　□土木工程　□水利工程　□材料工程 □環境工程　□醫學工程　□奈米科技　□微流體晶片 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □生物 科技 | □基因工程　□生醫檢測　□生物藥學　□生物晶片 □微生物　　□動物疫苗　□資電晶片　□蛋白質工程 □保健食品 □農業技術　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □材料 化工 | □藥物化學　□材料化學　□光電材料　□化妝品化學　 □分析化學 □生醫材料　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □管理 | □資訊系統管理　□工業管理　□電信管理 □企業管理模式　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| □其他 | □生活應用　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| （四）  本技術 創作目的  **（必填）** |  | | |
| （五）  技術摘要  **（必填）**    （簡述本技術的特徵，並說明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途，以200字左右為宜） |  | | |
| （六）  本發明之特色  **（必填）**  （以至少一個最佳實施例說明本發明之技術與特徵） | * 1. 既有技術之比較   2. 本發明之特點 | | |
| （七）  發明或 創作說明  **（必填）**  （應載明有關之先前技術，發明或 創作之目的、技術內容、特點、功效及圖示說明，使熟習該項技術者能了解其內容並可據以實施） |  | | |
| （八）  申請專利範圍  **（必填）**  （即claims，應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵；亦即應指定申請專利之標的名稱，並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。） |  | | |
| （九）  圖示  **（必填）** |  | | |

三、技術推廣

|  |  |
| --- | --- |
| （一）  技術成熟度 | □量產階段　　　□試量產階段　　□雛型階段  □實驗室階段　　□概念階段　　　□其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| （二）  產業應用性  **（必填）**  （請詳細列舉此技術可能應用的產業、可運用本技術之產品、方式等） | 1. 產業利用性說明 2. 是否正在（或將要）進行相關產學合作或技術授權 |
| （三）  適用產業類別  **（必填）** | □積體電路產業　□電腦及週邊產業 □通訊產業　　 □光電產業  □精密機械產業　□運輸工具產業　 □機械設備製造 □製藥工業  □化學製品製造業□化學材料製造業　□石油及煤製品製造業  □橡膠製品製造業□農藥工業　　　□生物技術產業　□食品製造業  □電子產業 　□金屬製品製造業□非金屬製品製造業　□紡織業　　 □印刷電路板　　□出版業　　　　□營建業　　　　 □環境檢測　 □諮詢顧問業　　□其他：＿＿＿＿＿＿＿ |
| （四）  技術承接單位 應具備條件之建議 | 1. 潛在廠商：   （1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   1. 廠商應具備之專門技術： 2. 廠商應有設備： |

東海大學研發成果  
專利申請費用分攤暨權益收入分配協議書

（專利申請表3）

一、專利名稱：

二、申請國別：

三、發明人專利費用分攤及權益收入分配，將依本校「研究發展成果管理辦法」及本協議書辦理。

（一）本校與屬本校發明人之**專利費用分攤比例**方案如下：

扣除資助機關補助金額後，專利申請費用（如專利申請之申請費、證書費、第一期專利年費、事務所手續費及其他依法令應繳納之專利規費等）之負擔比率得由本校人員之發明人依下列方案自行選擇其中之一，並經研發成果管理委員會決議之。此五種方案之選擇將影響研發成果收益之分配比例。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 專利費用分攤方案 | 專利申請費用分攤（%） | | 收益分配比例（%） | |
| 本校 | 發明人 | 本校 | 發明人 |
| **一** | 100 | **0** | 75 | **25** |
| **二** | 85 | **15** | 55 | **45** |
| **三** | 70 | **30** | 40 | **60** |
| **四** | 55 | **45** | 25 | **75** |
| **五** | 0 | **100** | 15 | **85** |

（二）屬本校之發明人間**權益收入分配比例**協議如下：

若屬本校之發明人為二人（含）以上，請自行協調並於下表填寫權益收入分配比例。日後有關本校發明人權益收入分配，將依此原則辦理之。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 發明人姓名 | 權益收入分配比例 | 備註 |
| 1 | （發明人代表） | % |  |
| 2 |  | % |  |
| 3 |  | % |  |
| 合 計 | | 100% |  |

四、本案經所有屬本校之發明人一致同意選擇第 方案為專利費用分攤比例；並同意上表發明人權益收入分配比例。

1. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
2. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日
3. 發明人：　　　　　　　　　　（簽章） 日期：　 　年　　月　　日

□**與其他單位共有聲明（請勾選）：**

此協議書僅適用於本校與東海大學發明人之專利費用分攤比例及屬本校發明人間之權益收入分配比例關係。與其他共有單位之相關權利義務，則依循雙（多）方共有合約規定辦理。

發明人代表：　　　　　　　　　　（簽章）